

3. 中間期の経営成績

【概況】

	中間期	前年同期比	増減率	再編影響を除く 継続事業の増減率
売上高	22,200 億円	781 億円	3.6 %	8.1 %
営業利益	332 億円	512 億円		
経常利益	40 億円	717 億円		
当期純利益	▲ 81 億円	504 億円		

< 売上高の前年同期比増減率 >

	増減率	再編影響を除く 継続事業の増減率	再編影響額 ▲ 888億円 < 主要な再編の内訳 >
売上高計	3.6%	8.1%	・富士通コンサルティングのスペイン事業売却
ソフトウェア・サービス	0.8%	2.0%	・フラッシュメモリ事業の合併化
プラットフォーム	8.9%	8.9%	・化合物半導体事業の合併化
電子デバイス	17.6%	27.1%	・FDK(株)の外部資本との提携
その他 ▲ 1.2%		23.7%	・リース事業の外部資本との提携

注) セグメント別は外部顧客に対する売上高。

・セグメント別営業利益

	中間期	前年同期比
ソフトウェア・サービス	155 億円	▲ 133 億円
プラットフォーム	37 億円	244 億円
電子デバイス	345 億円	357 億円

当中間期の売上高は2兆2,200億円で、前年同期比3.6%の増収となりました。ソフトウェア・サービスは微増ですが、第3世代携帯電話用基地局や新紙幣対応の金融端末装置のほか、デジタルAV機器向けシステムLSIやHDDも好調でした。また、昨年度の再編影響を考慮すると前年同期比8.1%の増収でした。

営業利益は332億円で、中間期では2000年度以来4年ぶりの利益となりました。前年同期比では512億円で大きく改善しました。ソフトウェア・サービスでは販売価格の下落の影響、採算性の悪化したプロジェクトに関する損失などにより減益となったものの、プラットフォームと電子デバイスでは売上増とコストダウンの効果により前年の赤字から益転し、これにより、第2四半期と同様に、主要3セグメント全てで利益を計上しました。

売上原価率は73.6%でハードウェアを中心に価格競争が激化する中、コストダウンへの取り組みを強化し、前年同期並みを維持しました。販売費及び一般管理費の売上高比は24.9%と、効率化の努力に加え、海外を中心とした再編による効果や子会社の持分法移行の影響もあり、前年同期から2%以上低下しました。売上原価と費用を合わせた総コストは売上高比で前年同期から2.3%改善しました。

経常利益は40億円で、前年同期比で717億円の大幅な改善となりました。営業利益の改善に加え、営業外損益では、有利子負債の減少等で金融収支が34億円、前年度の株価の上昇や代行返上により退職給付積立不足償却額が92億円、また、持分法による投資利益も41億円の改善となりました。AMD社とのフラッシュメモリ合併会社やアルカテル社との海外向け第3世代携帯電話用基地局の合併会社の損益が改善し、売却によるファナック社の持分法からの離脱影響を吸収しました。その他には為替差額(当中間期は22億円の差益)が63億円改善しました。

この結果、当期純利益は81億円の損失、前年同期比では504億円改善しました。

【セグメント別の状況】

当中間期の外部顧客向け売上高及び営業利益のセグメント別の状況は以下の通りです。

ソフトウェア・サービス

	中間期	前年同期比増減率	再編影響を除く 継続事業の増減率
売上高	9,165 億円	0.8 %	2.0 %
国内	6,677 億円	▲ 0.5 %	▲ 0.5 %
海外	2,487 億円	4.6 %	9.5 %

・売上高の内訳

	中間期	前年同期比増減率
ソリューション/SI	3,928 億円	▲ 5.1 %
インフラサービス	5,237 億円	5.7 %

売上高は9,165億円で、前年度の海外事業の再編の影響を除くと前年同期比で2.0%の増収となります。国内ではソリューション/SIが価格低下圧力などにより売上が伸び悩む一方で、海外では昨年度に政府系大型アウトソーシング商談を連続して受注した英国の富士通サービスの売上高が伸長しました。

	中間期	前年同期比
営業利益	155 億円	▲ 133 億円

営業利益は155億円で、前年同期比で133億円の減益となりました。米国の富士通コンサルティングが昨年度の事業構造改善効果、英国の富士通サービスが政府系大型アウトソーシング商談の増収効果により、それぞれ前年同期から改善しました。しかしながら、国内のソリューション/SI事業では、昨年度より引き続いた価格低下圧力に対してコストダウンが及ばなかったほか、採算性の悪化したプロジェクトに関して新規および追加の損失が発生し、前年同期比で減益となりました。

2003年度に損失計上した回収不能見込額683億円のうち、当中間期までに完了・引渡したものは220億円でした。採算の悪化したプロジェクトについては、現在新しい体制の下で損失の削減に注力する段階に入っています。

本年6月下旬には営業とSEを一体化する組織再編を行いました。窓口の一本化によりスピードアップを図りお客様の満足度を向上させ、ソリューションビジネスにおいて確実に利益を出せる事業構造への転換を図るとともに、今後はハードウェアビジネスまでを一元化して管理し、お客様起点で全社ベースでの収益力の強化を図ってまいります。7月には東北地区で、10月にも四国地区でSE子会社を統合し、12月には中国地区でSE子会社を再編します。合わせてSE子会社の購買業務を当社に集約、一元化し、購買機能を強化いたします。

価格低下圧力に対するコストダウンへの取り組みとしては、昨年刷新した総合システム開発体系「SDAS」の適用率を上げ、開発期間の短縮など徹底的に効率を上げていきます。さらに、「TRIOLE」コンセプトに基づいてオープンな環境下でのシステム構築パターンを事前検証し、徹底的に信頼性を高めた「Piテンプレート」を充実させることで、競合他社との差異化を図ってまいります。12月には国内最大規模のプラットフォームソリューションセンターを開設し、当社及び多数のベンダー様のプラットフォーム製品を取り揃え、コンサルティングから組み合わせの検証までを1ヶ所で行えるようにいたします。

本年10月には、お客様のライフサイクルマネジメント（LCM）全般にわたるサポートの充実を図るために、システムサポートとアウトソーシングサービスの中核である富士通サポートアンドサービス㈱を当社の完全子会社にいたしました。コールセンターなどの保守機能を同社に集約することにより、お客様先での運用を支援するサービスを充実させ、システムの提供から運用まで、お客様に密着して最適なソリューションを提供してまいります。

また、プロジェクト管理の強化に向けて、進行基準の導入などの取り組みを積極的に進めております。

進行基準などプロジェクト管理の強化への取り組みについて

上期はソリューション/ＳＩビジネスのプロジェクト管理の強化として、進捗測定の見直し及び可視化を図ったことに加え、第1四半期に実施した営業とＳＥの組織一体化でのＳＩ開発プロセス強化策として、特に大規模プロジェクトにおいて第三者による社内監査制度を導入し一層の強化を図りました。現在はソリューション/ＳＩの全てのビジネスグループで、プロジェクトを選定し、試行運用を開始するとともに進捗測定と評価について検証しております。下期からは、2005年度からの適用に向けて推進体制をより強固なものとするため専任者を中心とした組織を立ち上げ、月次進捗管理の浸透に努めるとともに引き続きお客様との契約関係の透明度を上げてまいります。また関係会社も含めた情報インフラの整備・連携を進めてまいります。

プラットフォーム

	中間期	前年同期比増減率
売上高	7,879 億円	8.9 %
国内	5,523 億円	9.4 %
海外	2,355 億円	7.7 %

・売上高の内訳

	中間期	前年同期比増減率
サーバ関連	1,740 億円	13.0 %
Eメール・IPネットワーク	1,030 億円	27.3 %
伝送システム	811 億円	0.6 %
パソコン/携帯電話	3,260 億円	1.2 %
HDD関連	1,038 億円	20.3 %

売上高は7,879億円で、前年同期比8.9%の増収でした。国内では、第3世代携帯電話用基地局や新紙幣対応の金融端末装置が好調であり、また、高品質で高信頼の製品が市場から評価されたHDDも大幅な増収となりました。

	中間期	前年同期比
営業利益	37 億円	244 億円

営業利益は37億円で、前年同期の207億円の大きな赤字から益転し、244億円改善しました。上記の増収効果やサーバ、IPネットワーク機器や光伝送システムのコスト削減により収益が改善しました。携帯電話は売上が低迷した上に高機能化に伴いコストアップしたことにより収益が大幅に悪化しました。

本年6月に当社の90ナノ半導体技術を採用した64ビットプロセッサを搭載したUNIXサーバを、国内販売と同時に、欧州の富士通シーメンスコンピュータズ(FSC)や北米の富士通コンピュータシステムズ(FCSS)などを通じて、グローバルに販売を開始し、一方では、サーバビジネスでのグローバルなパートナーとの戦略的提携を進めました。

UNIXサーバでは、サン・マイクロシステムズ社と提携しました。2006年度提供開始を目標として当社のデバイステクノロジーを使った次期製品を共同開発し、統合ブランドで両社の販売チャンネルを通じて提供することに合意しました。欧州では10月から両社の既存製品の相互供給を開始し、北米においても実施を計画しています。

IAサーバでは、従来から提携関係にあるインテル社に加えて、マイクロソフト社と提携を強化し、2005年に当社が提供する予定の次世代基幹IAサーバとマイクロソフト社の次期OSについて、ミッションクリティカル分野で協業していくことを合意しました。

HDD用ヘッド事業ではTDK(株)と提携し、当社のフィリピン子会社のヘッド組立部門とTDK(株)のフィリピン子会社を統合することにつき基本合意しました。

セキュリティ分野では生体認証技術のニーズが高まり、当社が開発した世界初の手のひら静脈認証技術が、スルガ銀行様の窓口や、東京三菱銀行様の新サービスに対応したATMに採用されました。また、お客様の情報漏えい対策のニーズから、決済機能の付いた第3世代携帯電話やモバイルノートパソコンに、指紋認証機能を付けました。

電子デバイス

	中間期	前年同期比増減率	再編影響を除く継続事業の増減率
売上高	3,935 億円	17.6 %	27.1 %
国内	2,199 億円	33.6 %	34.2 %
海外	1,735 億円	2.0 %	19.1 %

・売上高の内訳

	中間期	前年同期比増減率
半導体	2,199 億円	20.6 %
その他	1,736 億円	13.9 %

売上高は3,935億円で、前年同期比17.6%の増収でした。化合物半導体事業やフラッシュメモリ事業が持分法対象となったことによる影響を除いた継続事業では27.1%の大幅な伸長です。国内では34.2%、海外でも19.1%の伸長です。ディスプレイではLCDが顧客在庫調整による物量減により前年同期より減収となったものの、デジタルAV機器向けシステムLSIや電子部品系子会社が引き続き好調でした。

	中間期	前年同期比
営業利益	345 億円	357 億円

営業利益は345億円で、前年の赤字から益転し、前年同期比で357億円の改善です。システムLSIや電子部品系子会社が増収とコストダウンの進展により大幅な利益増となりました。一方、PDPでは価格低下影響で利益が大きく減少したほか、第1四半期まで好調だったLCDも第2四半期に入り市況が急激に悪化し、利益が減少しました。

本年4月に着工した三重工場の90/65ナノメートル先端テクノロジー用の300ミリメートルウェハ量産工場は計画通りに建設が進んでいます。米国ラティス社とは製品代金をラティス社が前払いする契約に合意し、前払金の一部の支払を受けております。

【所在地別の状況】

・売上高の内訳

	中間期	前年同期比増減率	再編影響を除く 継続事業の増減率
日本	16,461 億円	1.8 %	6.6 %
欧州	2,740 億円	12.2 %	16.9 %
米州	1,366 億円	16.6 %	22.0 %
アジア・豪州他	1,632 億円	▲ 0.5 %	0.7 %

・営業利益の内訳

	中間期	前年同期比
日本	526 億円	364 億円
欧州	20 億円	40 億円
米州	21 億円	99 億円
アジア・豪州他	50 億円	▲ 1 億円

米州が昨年度の事業再編の効果で前年同期比で99億円改善し、21億円の利益を計上したほか、売上好調な欧州でも前年同期比で40億円改善し、20億円の利益を計上しました。この結果、日本、アジア・豪州とともにすべての所在地別セグメントで営業利益を計上しました。